

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-31

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 其他（_____）
活动参与人 员（排名不 分先后）	国海证券、第一创业证券、华美国际投资、深圳纽富斯投资、3W Fund Mgmt LTD、ARROWPOINT INVESTMENT PARTNERS、Allianz Asia、Amundi Pioneer (Asia)、BOCI Prudential Asset Management、Boyu Capital Inv Mgmt Co Ltd、Cathay Life Insurance、Cathay Securities Investment Trust、Certitudo、China Universal Asset Management HK、Dymon Asia Capital (Singapore)、Fidelity International (FIL)、Fidelity Management & Research、Fullgoal Fund Management、GUOTAI JUNAN INTL AM SG PTE LTD、Goldman Sachs Asset Management、LYGH Capital PTE Ltd、Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Monolith Management Ltd、Neuberger & Berman、Nomura Asset Management、Oversea-Chinese Bank、POLYMER CAPITAL MAN (HK)、Pictet AM、Pleiad Investment Advisors Ltd、RHB Investment Bank Bhd、Schroder Inv Management HK、Springs Capital (Hong Kong)Ltd、Sumitomo Mitsui DS AM CO、T Rowe Price、Value Partners
上市公司 接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2025 年 9 月 18 日
地点	公司会议室、网络及电话会议
形式	实地调研、网络及电话会议
投资者关系 活动主要内 容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍 2025 年上半年公司 PCB 业务营业收入及毛利率的变动原因。 PCB 产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。 2025 年上半年，PCB 业务实现主营业务收入 62.74 亿元，同比增长 29.21%；业务毛利

率 34.42%，同比增加 3.05 个百分点。PCB 业务把握算力以及汽车电子市场的机遇，实现营收和利润的稳健增长。营收层面的增长贡献主要为 AI 加速卡等产品需求释放，数据中心领域占比进一步提升；400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著提升，有线侧占比增加；以及汽车电子需求增长。毛利率在营收规模增加、产能利用率相对高位、产品结构优化的情况下亦有所提升。

Q2、请介绍 2025 年上半年公司封装基板业务营业收入及毛利率的变动原因。

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片类封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。

2025 年上半年，封装基板业务实现主营业务收入 17.40 亿元，同比增长 9.03%，业务毛利率 15.15%，同比减少 10.31 个百分点。公司封装基板业务把握国内存储市场增长的机遇，加大市场拓展力度，推动订单较去年同期显著增长。封装基板业务毛利率同比下降，主要由于广州封装基板项目处于产能爬坡阶段，金盐等部分原材料涨价，使得成本及费用较同期增加。

Q3、请介绍公司 2025 年上半年 PCB 业务产品下游应用经营情况。

公司在 PCB 业务方面从事中高端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。

2025 年上半年，通信、数据中心、汽车电子等领域对 PCB 业务营收增长均有贡献。在通信、数据中心领域，400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著增长，AI 加速卡、服务器等相关配套产品的需求提升，营收增长明显。在汽车领域，公司继续把握汽车电子需求增长的发展机遇，实现了订单收入的增加。PCB 业务毛利率的增长主要得益于营收规模增加，PCB 工厂产能利用率进一步提升，AI 相关领域订单需求增长助益 PCB 业务产品结构优化。

Q4、请介绍公司 PCB 业务在 AI 算力方面的布局情况。

伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，电子产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需

求的提升。2024 年以来，公司 PCB 业务在通信交换机及光模块、数据中心 AI 加速卡等领域的 PCB 产品需求均受益于上述趋势。

Q5、请介绍公司上半年工厂产能利用率情况。

公司 PCB 业务因算力及汽车电子市场需求持续提升，工厂综合产能利用率处于相对高位；封装基板业务受国内存储市场的需求明显提升，工厂综合产能利用率同比明显改善。

Q6、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国均设有工厂。PCB 新增的产能主要来自于两个方面，一方面公司通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级；另一方面，公司有序推进南通四期项目及泰国工厂建设，南通四期项目预计今年四季度连线，泰国工厂目前已连线。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q7、请介绍广州封装基板项目连线及产能爬坡进展。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡阶段，重点仍聚焦能力建设及市场开发，2025 年上半年广州广芯亏损环比有所收窄。

Q8、请介绍公司 PCB 产品对 HDI 技术的应用情况。

HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

Q9、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。公司电子装联业务 2024 年及 2025 年上半年分别实现主营业务收入 28.23 亿元、14.78 亿元，分别占公

	司营业总收入的 15.76%、14.14%。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无